

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年11月23日(23.11.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/224021 A1

(51) 国際特許分類:

C08F 212/00 (2006.01) *C08J 5/24* (2006.01)
B32B 15/08 (2006.01) *H01L 23/29* (2006.01)
C08F 222/40 (2006.01) *H01L 23/31* (2006.01)
C08F 290/14 (2006.01) *H05K 1/03* (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2023/018197

(22) 国際出願日: 2023年5月16日(16.05.2023)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2022-082081 2022年5月19日(19.05.2022) JP

(71) 出願人: 株式会社 レゾナック (**RESONAC CORPORATION**) [JP/JP]; 〒1057325 東京都港区東新橋一丁目9番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 山下 剛 (**YAMASHITA Takeshi**); 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目13番9号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP). 小竹 智彦(**KOTAKE Tomohiko**); 〒1058518 東京都港区芝大門一丁目13番9号 株式会社レゾナック内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 弁理士法人大谷特許事務所(**OHTANI PATENT OFFICE**); 〒1050001 東京都港区虎ノ門三丁目25番2号 虎ノ門Eビル7階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,

BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) **Title:** RESIN COMPOSITION, PREPREG, LAMINATE, RESIN FILM, PRINTED WIRING BOARD AND SEMI-CONDUCTOR PACKAGE

(54) 発明の名称: 樹脂組成物、プリプレグ、積層板、樹脂フィルム、プリント配線板及び半導体パッケージ

(57) **Abstract:** The present invention provides: a resin composition which contains (A) one or more substances that are selected from the group consisting of maleimide resins having one or more N-substituted maleimide groups and derivatives of the maleimide resins and (B) a compound that has a vinylbenzyl group, wherein the component (B) contains one or more compounds that are selected from the group consisting of (B1) compounds having three or more vinylbenzyl groups which are each bonded to an oxygen atom and (B2) compounds having one or more vinylbenzyl groups which are each bonded to a carbon atom; a prepreg which uses this resin composition; a laminate; a resin film; a printed wiring board; and a semiconductor package.

(57) 要約: (A) N-置換マレイミド基を1個以上有するマレイミド樹脂及びその誘導体からなる群から選択される1種以上と、(B) ビニルベンジル基を有する化合物と、を含有し、前記(B)成分が、(B1) 酸素原子に結合するビニルベンジル基を3個以上有する化合物、及び(B2) 炭素原子に結合するビニルベンジル基を1個以上有する化合物からなる群から選択される1種以上を含有する、樹脂組成物、該樹脂組成物を用いたプリプレグ、積層板、樹脂フィルム、プリント配線板及び半導体パッケージである。

WO 2023/224021 A1